

2010年8月26日

TANAKAホールディングス株式会社

## 田中電子工業(株)、 2008年1月～2010年6月のボンディングワイヤ出荷量を発表

- リーマンショック後に半減するも、2010年上半期にはリーマンショック前を上回る出荷量に回復
- 銅は2008年上半期と比べ906%に！金の価格高騰により銅への代替が本格化
- パワーデバイスや太陽電池などの需要増により、アルミが出荷量を伸ばす

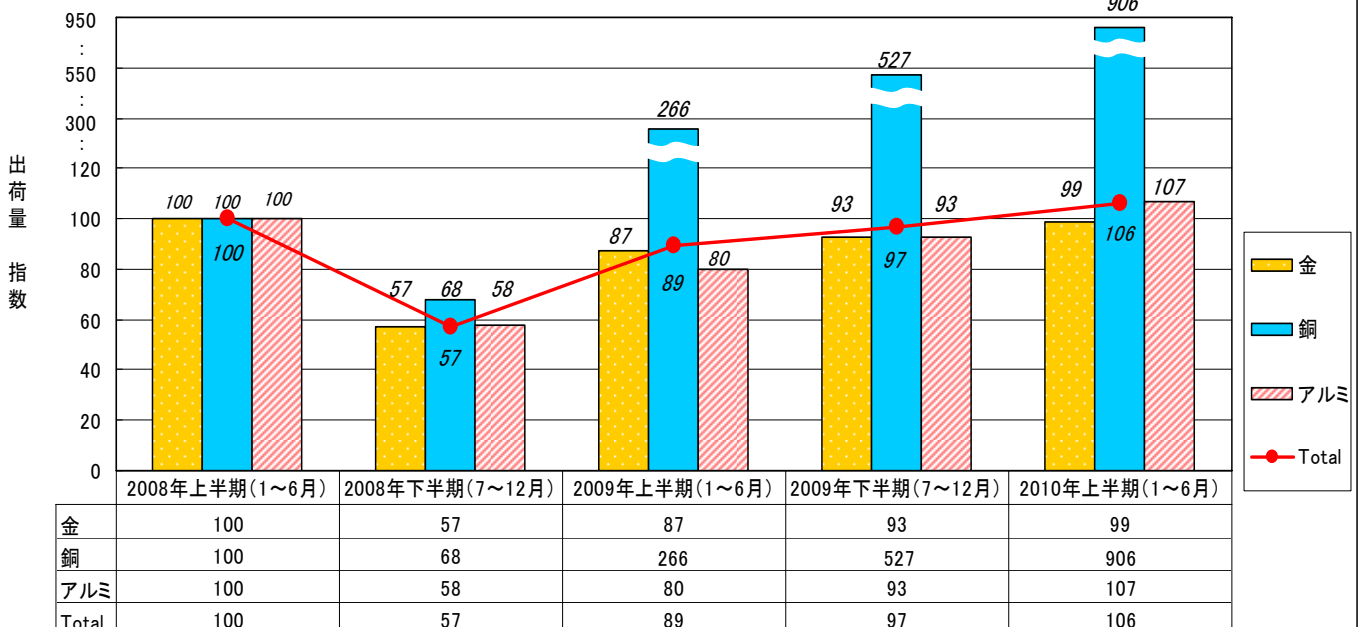
TANAKAホールディングス株式会社（本社：千代田区丸の内、代表取締役社長：岡本英彌）は、ボンディングワイヤ製造で世界トップシェアを誇る、田中貴金属グループの田中電子工業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：笠原康志）が、2008年1月から2010年6月までの金、銅、およびアルミのボンディングワイヤ出荷量（指数）をまとめたことを発表します。

### 【全体的（金・銅・アルミ）な出荷量推移】

リーマンショック前にあたる2008年上半期の出荷量を基準にすると、ボンディングワイヤの全体的な出荷量は、リーマンショック後の2008年下半期に57%にまで減少し、底を打ちました。その後、顧客の在庫改善が進み、2009年上半期以降の出荷量は回復を続け、2010年上半期にようやくリーマンショック前を上回る106%に回復しました。

### ボンディングワイヤ出荷量の推移

※2008年上半期(1月～6月)の出荷量を100とした指数



#### 【金ボンディングワイヤ出荷量推移】

リーマンショック前にあたる 2008 年上半期の出荷量を基準にすると、2008 年下半期には 57%にまで減少し、底を打ちました。その後、出荷量は回復傾向をたどり、金の国際価格が市場最高値を更新し続ける中、2010 年上期にはリーマンショック前とほぼ同じ値（99%）にまで回復しました。

金は高耐食性や高導電性などの優れた特性を持つため、従来よりボンディングワイヤの主力プレーヤーとして総出荷量を牽引し、依然として高い需要を保っています。

#### 【銅ボンディングワイヤ出荷量推移】

リーマンショック後の 2008 年下半期には 68%にまで減少しましたが、金の価格高騰が進む中、金よりも安価な代替金属として銅に注目が集まり、2009 年上半期から急激に出荷量が上昇。2010 年上半期には 906%にまで上昇しました。銅は金に比べて温度変化や湿度に弱く、酸化しやすいため、品質安定性が低いという問題がありましたが、銅の加工技術の向上を背景に、金に代わる金属として需要が高まっており、今後も更なる増加が見込まれます。

#### 【アルミボンディングワイヤ出荷量推移】

金や銅と同様、リーマンショック後の 2008 年下半期には 58%にまで減少。これを底に出荷量は回復に転じ、2010 年上半期にはリーマンショック前を上回る 106%にまで回復しました。アルミは化学的に安定した材料であり、金に比べ安価で太線化も容易なことから大電流を流すことができるため、ハイブリッド車（HV）の IGBT※1 などパワーデバイス分野で需要が拡大。

また太陽電池や、エコ商品、環境対策向け製品での需要拡大に加え、インバーターを搭載した家電製品が中国で普及するなど、環境や省エネルギーへの配慮が高まっており、アルミボンディングワイヤの出荷は現在も順調に伸び続けております。

現在、田中電子工業では、独自の合金技術を用いた銅製ワイヤ「CLR-1（クリアーワン）※2」や、アルミボンディングワイヤの販売を強化するなど市場のニーズに対応しており、今後も市場動向を見極め、技術開発を進めてまいります。

---

※1 IGBT：Insulated gate bipolar transistor の略。ゲート部に電界効果トランジスタが組み込まれたバイポーラトランジスタ。電圧制御で大きな電力を扱えるため、大電力のスイッチングに使用されている。

※2 CLR-1：田中電子工業独自の合金技術により、銅表面にパラジウムを皮膜させ耐腐食性や接合密着安定性を高機能化させた銅製ワイヤ。

## ■TANAKA ホールディングス株式会社（田中貴金属グループを統括する持株会社）について

本社：東京都千代田区丸の内 2-7-3 東京ビルディング 22F

代表：代表取締役社長 岡本 英彌

創業：1885 年

設立：1918 年

資本金：5 億円

従業員数：3,434 名（2009 年度グループ連結）

売上高：7,102 億円（2009 年度グループ連結）

グループの主な事業内容：貴金属地金（白金、金、銀 ほか）及び各種工業用貴金属製品の製造・販売、輸出入及び貴金属の回収・精製

HP アドレス：<http://www.tanaka.co.jp>

工業製品アドレス：<http://pro.tanaka.co.jp>

## ■田中電子工業株式会社について

本社：東京都千代田区丸の内 2-7-3 東京ビルディング 22F

代表：代表取締役社長 笠原 康志

設立：1961 年

資本金：18 億 8 千万円

従業員数：133 名（2009 年度）

売上高：399 億 8 千万円（2009 年度）

事業内容：各種ボンディングワイヤの製造

HP アドレス：<http://www.tanaka-bondingwire.com/>

### <田中貴金属グループについて>

田中貴金属グループは 1885 年（明治 18 年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。2010 年 4 月 1 日に TANAKA ホールディングス株式会社を持株会社（グループの親会社）とする形でグループ再編が完了しました。ガバナンス体制を強化するとともにスピーディーな経営と機動的な業務執行を効率的に行うことにより、お客様へのより一層のサービス向上を目指します。そして、貴金属に携わる専門家集団として、グループ各社が連携・協力して多様な製品とサービスを提供しております。

国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇る田中貴金属グループでは、工業用貴金属材料の開発から安定供給、装飾品や貴金属を活用した貯蓄商品の提供を長年に渡り行ってきました。今後も貴金属のプロとしてグループ全体で、ゆとりある豊かな暮らしに貢献し続けます。

田中貴金属グループの中核 8 社は以下の通りです。

- ・ TANAKA ホールディングス株式会社（純粋持株会社）
- ・ 田中貴金属工業株式会社
- ・ 田中貴金属販売株式会社
- ・ 田中貴金属インターナショナル株式会社
- ・ 田中電子工業株式会社
- ・ 日本エレクトロプレイング・エンジニアーズ株式会社
- ・ 田中貴金属ジュエリー株式会社
- ・ 田中貴金属ビジネスサービス株式会社